

MIC-715-OX

基于NVIDIA® Jetson Orin™ NX的
强固型车载AI无风扇系统

Preliminary



特性

- 强固型IP67防水无风扇设计
- 搭载 NVIDIA® Jetson Orin™ NX，最高算力达 100 TOPS
- 2 × GbE 及 4 × PoE，遵循 IEEE 802.3af 标准
- 2 × USB 3.0，2 × CAN 总线，1 × HDMI
- 支持 2 × mPCIe，1 × M.2 3052，1 × M.2 2280
- 支持 Allxon 7 × 24 小时远程监控及 OTA 部署
- 通过 e-mark 认证

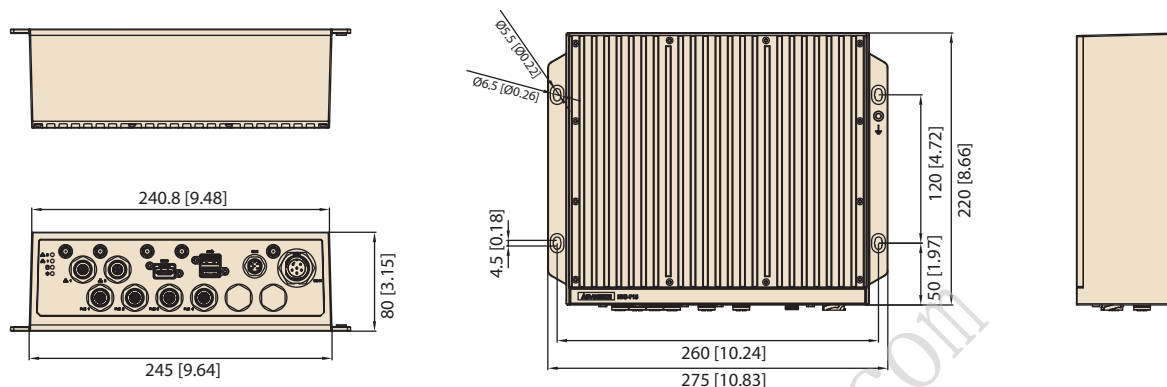
规格

		NVIDIA® Jetson Orin™ NX
处理器系统	CPU	16GB: 8-core NVIDIA Arm® Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU
	GPU	1024-core NVIDIA Ampere GPU with 32 Tensor Cores
	内存	16GB LPDDR5
	闪存	-
I/O	以太网	6 x 10/100/1000 Mbps (4 x PoE support, IEEE 802.3af) in M12 X-coded, 8-pin female connector
	显示	HDMI (Max. resolution 3840 x 2160 @ 60Hz)
	USB	External: 2 x USB 3.0
	CAN Bus	2 x CAN bus
	OTG USB	1 x Micro USB
扩展	Mini PCIe	2 x mPCIe (signal: PCIe + USB)
	SIM	2 x Nano SIM slot (M.2 3052 & Mini PCIe2 slot)
	M.2	1 x M.2 3052 (B-Key, signal: PCIe + USB)
存储	M.2	1 x M.2 2280 M-Key (NVMe, PCIe x1)
电源	模式	M16, 6-pin male
	输入功率	12/24V _{DC} (12-6A) with ignition *Note1
工作环境	工作温度	-20 ~ 60 °C with 0.7 m/s airflow (Max-N ARM mode)
	工作湿度	95% @ 40 °C (非冷凝)
	振动	3 Grms @ 5 ~ 500 Hz, random, 1 hr/axis
	冲击	10G/11ms
物理特性	尺寸 (宽 × 深 × 高)	275 x 220 x 80 mm (10.8" x 8.7" x 3.2")
	重量	4.5 kg
	安装	Desktop
BSP	Jetpack	Above 5.1
认证		CB/UL/CE/FCC/CCC (No RED certification)

注1：默认设置为12V DC输入。若电源为24V，请打开机箱并将SW1 DIP开关调至01位置以适配24V DC输入。

尺寸

单位:mm [inch]



订购信息

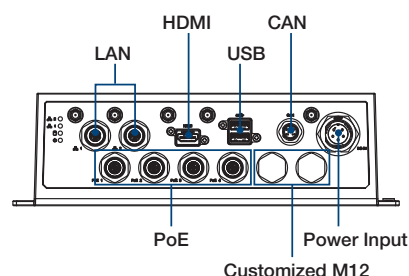
料号	NVIDIA 模块	内存	已安装的 JetPack 版本	NVMe**	超级模式支持
MIC-715-0X4A1	Orin NX	16GB	JP6.0	128GB pre installed	NO
MIC-715-0X4A2	Orin NX	16GB	NA	NA	NO

**系统 BSP 将预装于 128GB NVMe M.2 SSD 中。

包装清单

料号	描述	数量
MIC-715-0X4A1	Ruggedized AI System based on Orin NX	1
1700023619-01	Micro USB Cable	1
1700032301-01	6-pin M12 power cable	1
1930005673-11	M2 Screws	2
1930008089	Mini PCIe Screws	2

前视图



仅限开发/测试使用

料号	描述
XSK320-LRS-150-12	Open Frame, A/D 100-240V 150W 12V

远程管理注册

注册 7 × 24 小时安全服务，即可在一个集中的云端门户——Allxon Portal 上获取远程设备管理的所有功能。

注册页面：https://allxon.com/jetson/device_enroll/

可选配件

类别	料号	描述	数量
Cable	1700025503-01	M Series Waterproof Cable 8P/RJ45-8P8C 100cm (M12 to RJ-45)	1
	1700022250-21	Type-A Waterproof Cable 5P(F) 200cm (CAN cable)	1
Thermal Kit	98R27150000	M2 3052 / Mini PCIe module thermal kit	1
Wifi	EWM-W173H01E	Wi-Fi 6+BT 5.0 Module 2.4/5GHz Mini PCIe	1
	1751000626-01	RF Cable SMA/F-R MHF1/113 BLK L250mm	2
	1751000460-01	Dipole Ant. Wi-Fi 6E SMA/M-R BLK L111.7mm IP54 (Wi-Fi)	2
5G	9656EWMG00E	Half-size miniPCIe to miniPCIe bracket set	1
	AIW-356-DQ	5G Sub6+GNSS M.2 3052 Key B (by region)	1
	1751000624-01	Cable Ant. SMA/F MHF4L/113 BLK L250mm (5G)	4
	1750009372-01	Ant.SMA/M 90/180 5G BLK 167mm RG178 (5G)	4
SSD	96FD80-P128-AH	APACER M.2 2280 NVME G4x4 128G -25°C ~ 85 °C	1
	96FD80-P256-AH	APACER M.2 2280 NVME G4x4 256G -25°C ~ 85 °C	1
	96FD80-P1TB-TS1	SSSTC M.2 2280 1TB NVME G4x4 SSD -25°C ~ 85°C	1
	SQF-C8MV2-128GDEDM	SQF PCIe/NVMe Gen.3 M.2 2280 OPAL 720-D 128G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C)	1
	SQF-C8MV2-256GDEDM	SQF PCIe/NVMe Gen.3 M.2 2280 OPAL 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C)	1
	SQF-C8MV2-512GDEDM	SQF PCIe/NVMe Gen.3 M.2 2280 OPAL 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C)	1
	SQF-C8MV4-1TDDEDM	SQF PCIe/NVMe Gen.3 M.2 2280 OPAL 720-D 1T 3D TLC BiCS5 (-20~85°C)	1
	SQF-C8MV4-2TDDEDM	SQF PCIe/NVMe Gen.3 M.2 2280 OPAL 720-D 2T 3D TLC BiCS5 (-20~85°C)	1
	SQF-C8MV2-128GDEDE	SQF PCIe/NVMe Gen.3 M.2 2280 OPAL 720-D 128G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C)	1
	SQF-C8MV2-256GDEDE	SQF PCIe/NVMe Gen.3 M.2 2280 OPAL 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C)	1
	SQF-C8MV2-512GDEDE	SQF PCIe/NVMe Gen.3 M.2 2280 OPAL 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C)	1
	SQF-C8MV2-512GDEDE	SQF PCIe/NVMe Gen.3 M.2 2280 OPAL 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C)	1